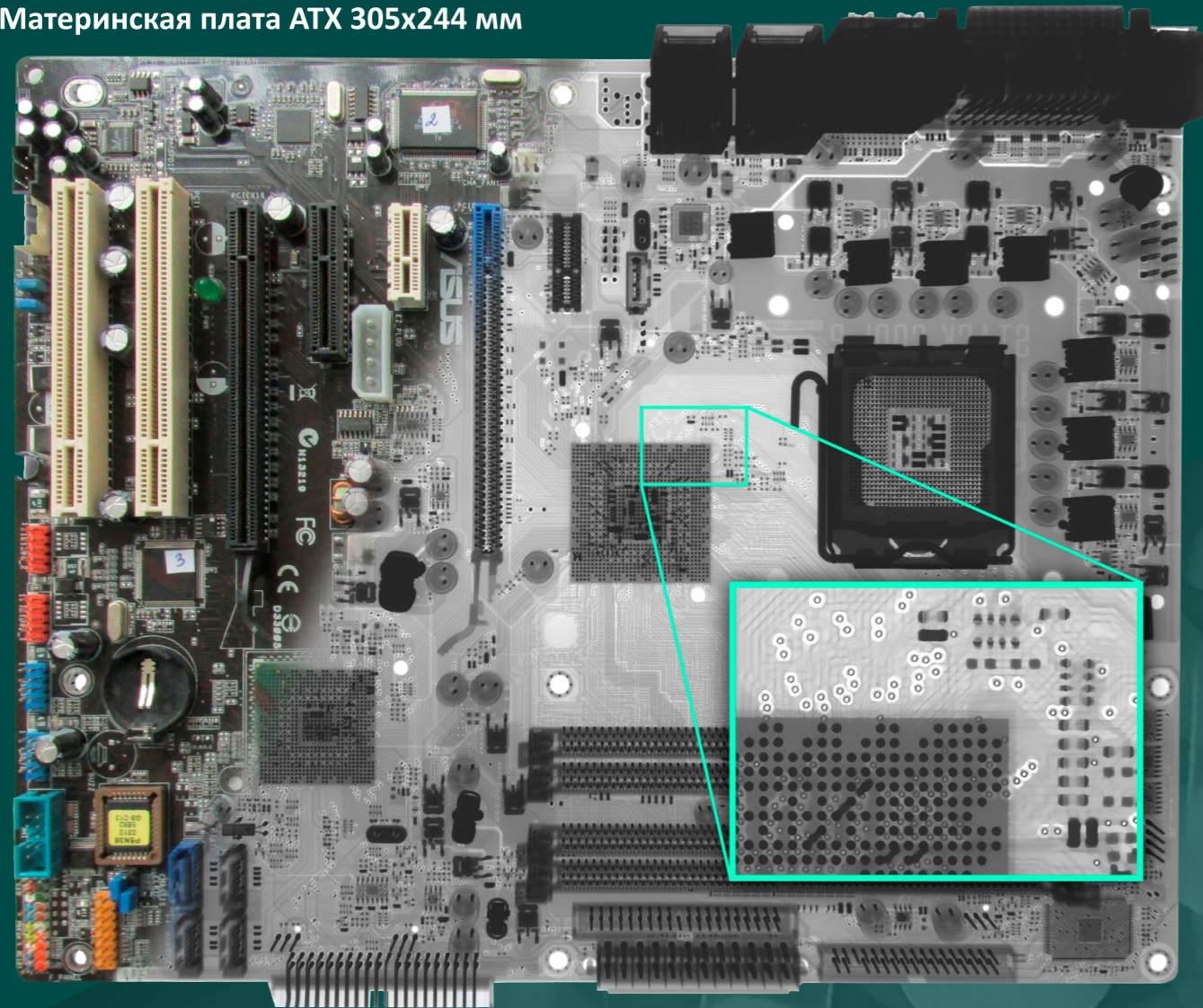
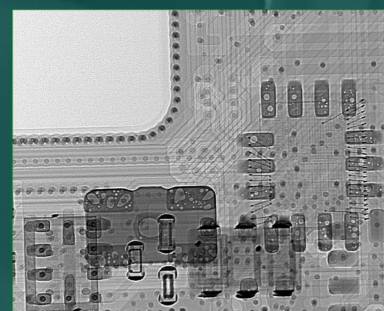


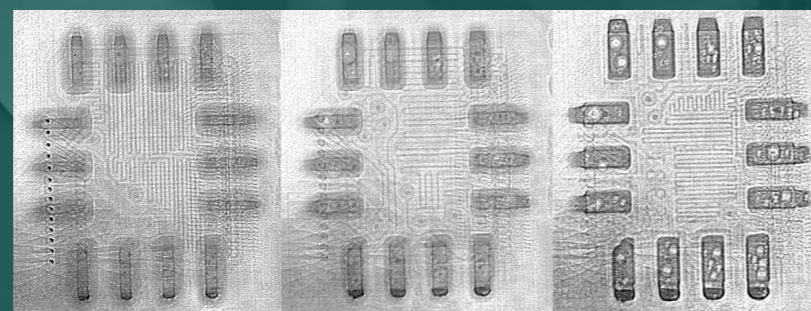
Материнская плата ATX 305x244 мм



Бесшовный рентгеновский снимок с разрешением 70 МП



Обычный снимок



Планарная томография (послойный анализ, томосинтез)

Разработчик и производитель
оборудования и программного
обеспечения - ООО "ПРОДИС.НДТ"

info@prodis.tech

Официальный дистрибьютор, сервис
и поддержка - ООО "ПРОМИНТ"

info@promint.ru



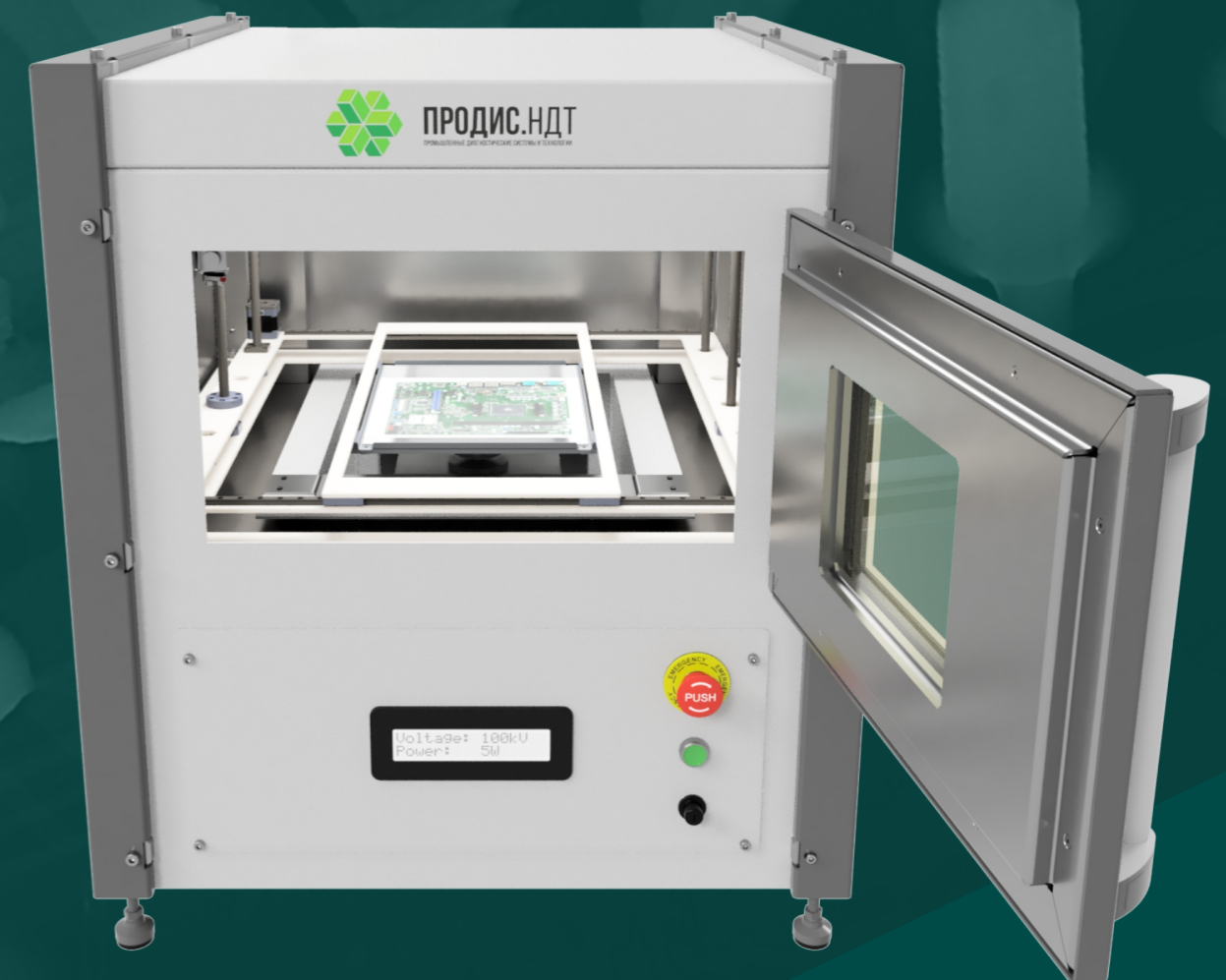
ПРОДИС.НДТ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ



Промышленные диагностические системы и технологии

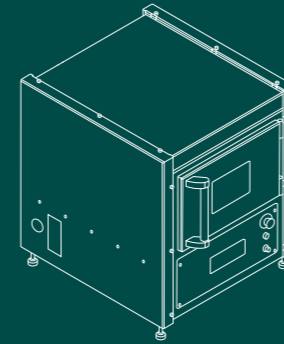
Система рентгеновской инспекции **ПРОДИС.Электро**

Рентгеновская инспекция электронных
изделий для выявления скрытых дефектов
в соединениях (BGA, QFN, IGBT, THT),
недоступных для оптического контроля



www.prodis.tech

Система рентгеновской инспекции ПРОДИС.Электро



Установочные параметры системы*

Габаритные размеры	780 x 930 x 930 мм
Масса системы	500 кг
Подключение	220В, 50Гц, 16А

* Опционально доступно напольное исполнение с ИБП и сервером данных



Основные преимущества

- Российская разработка и производство
- Компактная система для любых помещений
- Поддержка платформы Intel и Эльбрус (Россия)
- Информационная безопасность с ОС Астра Линукс
- Обработка фильтрами в реальном времени
- Анализ под наклоном в любом направлении
- Лучшее в своем классе качество изображения
- Бесшовные панорамные снимки всего изделия
- Послойный анализ (томосинтез) в комплекте
- Автоматизация инспекции серийных изделий
- Опция полноценной 3D микротомографии
- Пусконаладочные работы и инструктаж за 1 день
- Сервис и гарантии от производителя в РФ



Микрофокусный источник

Модель источника	РАП100	РАП150	U110	U130	H110
Напряжение	до 100 кВ	до 150 кВ	до 110 кВ	до 130 кВ	до 110 кВ
Мощность на мишени	10 Вт	22,5 Вт	25 Вт	65 Вт	16 Вт
Разрешение по тесту JIMA	15 мкм	15 мкм	7 мкм	8 мкм	2 мкм

* Возможна комплектация источником высокого разрешения до 1 мкм

Плоскопанельный детектор ПРОДИС.Марк 1215С*

Технология детектора	КМОП	КМОП
Разрешение детектора	6,7 МП (2900 x 2300)	4 МП (2280 x 1812)
Размер пикселя	49,5 мкм	64 мкм

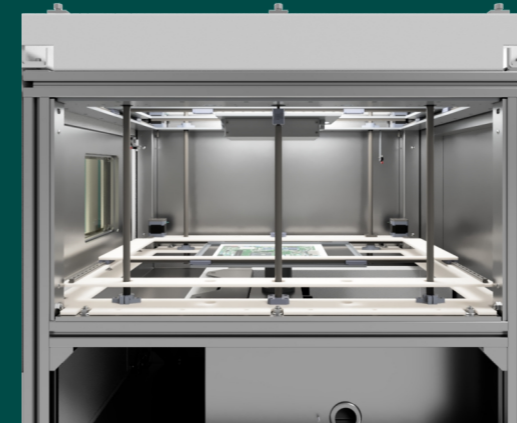
* Собственная топология фотосенсора

Применение рентгеновской инспекции

- Инспекция скрытых дефектов BGA, QFN, THT
- Входной контроль печатных плат и компонентов
- Приемка изделий без вскрытия упаковки
- Анализ отказов нарушающим способом
- Дефекты нанесения паяльной пасты
- Автоматизация инспекции серийных изделий
- Реверс инжиниринг и восстановление топологии
- Спецпроверка радиоэлектронного оборудования
- Документирование ответственных изделий



Обрыв дорожки Короткое замыкание

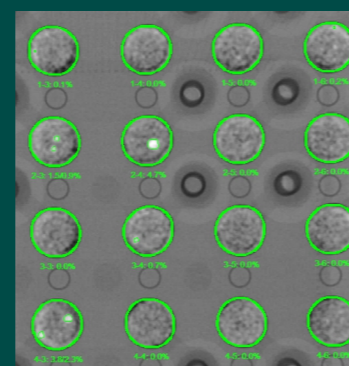


Система перемещения

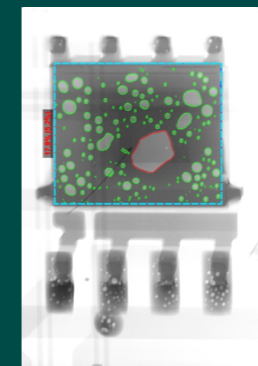
Число осей перемещения	5 (и ось томографии - опция)
Геометрическое увеличение	1,2x - 25x (100x опция)
Размеры образца	до 320 x 250 мм
Масса образца	до 5 кг
Инспекция под углом	до 45°
Направление наклона	0 - 360°
Бесшовная сшивка	Да

Возможности программного обеспечения

- Анализ BGA: перемычки, размер, форма, пустоты
- Бесшовная панорамная сшивка изображений
- Рентгеновская, оптическая и CAD навигация
- Документирование оригиналов снимков
- Параметрическая обработка изображений
- Счетчик компонентов в любой упаковке
- Подсчет площади пустот паяных соединений
- Сравнение с эталоном и выделение различий
- Маркировка дефектов и создание отчетов



Анализ пустот BGA



Подсчет пустот

Программное обеспечение proDIS

Совместимая платформа	Эльбрус, Intel
Совместимая ОС	Астра Линукс*

* Возможна комплектация Microsoft Windows 10

Дополнительные модули ПО:

- Автоматизация инспекции и анализа серийных изделий
- Послойный анализ (томосинтез, планарная томография)
- Модуль томографии с 3D реконструкцией и визуализацией
- Автоматизация подсчета компонентов SMD
- Разработка модулей под задачи заказчика